



関係各位

ISSM 組織委員会委員長

一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 (NEDIA) 齋藤 昇三

ISSM 組織委員会副委員長

アトナープ株式会社 井上 修一

ISSM 組織委員会副委員長

東芝ナノアナリシス株式会社 嶋崎 綾子

ISSM 運営委員会委員長

東芝デバイス&ストレージ株式会社 加藤 浩朗

第 31 回半導体生産技術国際シンポジウム「ISSM2026」協賛募金のお願いについて
2026 年 12 月 7 日(月)～8 日(火)に、KFC ホール(東京・両国)開催予定

拝啓 ますますご清祥の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は、ISSM(半導体生産技術国際シンポジウム)にご厚情を賜りまして誠に有難うございます。

ISSM は 1992 年発足以来、皆様のご支援を賜り、これまでの 30 回の実績から半導体生産技術に関する最も重要な国際会議の一つとして認知をいただき、半導体生産におけるメジャー会議としての位置づけを確立しております。

ISSM は、科学的視点に立ち半導体製造の進歩に貢献しており、中長期的な改善や短期且つ実施可能な改良を共有する活動を続けてきました。デバイスメーカーに加えて材料メーカー・装置メーカーの参画も得て、データに基づきプロセスから装置制御・材料・デバイス・工場運営に亘る生産技術・製造技術を議論する唯一の場として存在感を高めています。ISSM は、「未来の半導体製造をデザインする」を念頭に、半導体生産の革新を主導し続けていきます。

現在、日本を含めて世界各国で新工場の投資・立ち上げが活発になっています。トランジスタの微細化を実現するため、新しいデバイス物理学の研究 や新材料の導入と併行し、フル枚葉製造による AI チップの超短 TAT 生産への新たな挑戦がホットな話題となっています。また、デバイスの進化に併せて 3D パッケージ・チップレット集積技術等についても積極的に検討が進められています。

さらに、脱炭素社会実現のための省エネルギープロセス装置や新規材料導入による新規構造デバイスの製造に向けたライン再構築・運営形態へ進化の議論も活発に行われ、生成 AI の活用やスマートファクトリによる半導体チップ製造に向けて企業と学術研究機関の議論と連携が一層必要となっています。

ISSM2026 では、日々の生産活動を基盤に、広い産業・技術動向の俯瞰視点・経営視点から将来を先取りした生産技術を担う研究者・技術者が議論を通じ研鑽する場を提供します。中核の技術者に加えて、次世代の若手半導体技術者や次々世代の学生の積極的な参加を強く期待します。

また、政府支援のもと急速に半導体国産化が動き始めているインドとのパートナー構築を進めており、ISSM2026 もインドはじめ国際連携を深めて参ります。

シンポジウムの開催は参加費にて運営されることが本来の姿と考え、参加者にとって魅力ある企画の推進に努めておりますが、半導体の将来を担う若手技術者並びに学生の参加を積極的に募るには、低めの参加費、もしくは無料の設定も必要と考えております。経費の大幅な節減を行いましても、参加費のみでシンポジウムを開催することは至難な状況です。

ISSM2026 に何卒、ご支援を頂きたく、ご寄付(協賛募金)にご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、講演論文の募集につきましてもあらためましてご依頼を申し上げますので、重ねましてよろしくお願い申し上げます。

敬 具

ISSM2026 大綱

1. 会議の名称

(和文名称) 第 31 回半導体生産技術国際シンポジウム 2026

(英文名称) International Symposium on Semiconductor Manufacturing 2026

(略 称) ISSM2026

2. 支援機関などの名称(予定)

Co-sponsored by:

Minimal Fab

Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ)

Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)

Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA)

Technical Sponsored by:

IEEE Electron Devices Society

Endorsement by:

The Japan Society of Applied Physics

3. 会期と開催地(予定)

会 期:2026 年 12 月 7 日(月)ー8 日(火)

開催地:KFC ホール(東京・両国)

4. ISSM2026 会議の概要

会議日程 2026 年 12 月 7 日(月)ー8 日(火)

会議内容(予定)

- ・ キーノートセッション(基調講演)
- ・ ハイライトセッション
- ・ オーラルプレゼンテーションセッション(一般講演)
- ・ インターラクティブ・ポスターセッション
- ・ チュートリアルセッション

会議の主題:半導体生産技術

Fab Management

- ・ 工場設計および搬送自動化(FD)
- ・ 製造ラインの戦略及び運営管理(MS)
- ・ 生産管理および制御(MC)
- ・ 環境・安全・健康(ES)
- ・ 工場データ管理(ID)

3D, Chiplets & Advanced Packaging

- ・ 3D 実装、チップレット・パッケージング
- ・ 先端パッケージ技術(TP)

Process Integration

- ・ プロセスおよび材料の最適化(PO)
- ・ 歩留まり向上(YE)
- ・ 汚染制御及びウルトラクリーンテクノロジー(UC)
- ・ プロセス制御・モニタリング(PC)
- ・ 製造装置・測定装置(PE)
- ・ 生産性設計(DM)
- ・ 新規デバイス向け製造技術(VD)

参加予定国:日本, 米国, 欧州諸国, アジア諸国, その他

参加予定者

日本、欧米、インド、アジアなどから 250 名

会議公用語

講 演

印刷物

英語

英語

ISSM2026 委員会組織(敬称略) 企業名アルファベット順記載

組織委員会

組織委員会	氏名	所属機関名	部署	役職名
組織委員長	齋藤 昇三	一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)		理事
組織副委員長	井上 修一	アトナーブ株式会社		アドバイザー
組織副委員長	嶋崎 綾子	東芝ナノアナリス株式会社		技師長
	和田 純一	キオクシア株式会社	メモリ技術研究所 プロセス技術研究開発センター	センター長
	井上 道弘	ミニマルファブ推進機構		アドバイザー
	多留谷 政良	三菱電機株式会社	パワーデバイス製作所	主管技師長
	小池 淳義	Rapidus株式会社		代表取締役社長
	奥野 泰利	株式会社SCREENホールディングス		執行役員 特命担当
	嵯峨 幸一郎	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社	研究開発センター 第2研究部門 2部4課	統括課長
	瀬川 澄江	東京エレクトロン株式会社	コーポレートイノベーション本部	執行役員 本部長代理
	加藤 浩朗	東芝デバイス&ストレージ株式会社	半導体事業部 先端半導体デバイス開発センター 先端半導体デバイス第一開発部	シニアマネジャー
	佐々木 智幸	タワー パートナース セミコンダクター株式会社		産学連会・渉外担当 Senior Principal

運営委員会

運営委員会	氏名	所属機関名	部署	役職名
運営委員長	加藤 浩朗	東芝デバイス&ストレージ株式会社	半導体事業部 先端半導体デバイス開発センター 先端半導体デバイス第一開発部	シニアマネジャー
	売賀 賢介	株式会社デュラシステムズ		代表取締役社長
	服部 毅	Hattori Consulting		国際ジャーナリスト テクニカルライター
	今井 伸一	株式会社日立ハイテク	ナノテクノロジーソリューション事業統括本部 事業戦略本部	本部長付 工学博士
	中馬 宏之	株式会社一貫堂		エグゼクティブ・ストラテジスト
	姜 帥現	キオクシア株式会社	先端技術研究所 デバイス・プロセス研究開発センター 先端プロセス研究開発部	部長
	西澤 伸一	九州大学	応用力学研究所 新エネルギー力学部門	教授
	多留谷 政良	三菱電機株式会社	パワーデバイス製作所	主管技師長
	井上 真幸	ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社	マニファクチャリングセンター ウェハプロセス技術部	部長
	小澤 克敏	オムロン株式会社	インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー セミコンダクタ&インキュベーションセンタ	経営基幹職 フェロー
	岡本 和也	大阪大学/日本工業大学	大阪大学 招聘教授 ナノデザインセンター、 日本工業大学 技術経営研究科 技術経営専攻	教授
	赤堀 浩史	Rapidus株式会社	常務執行役員オペレーション	
	森 啓之	ルネサス エレクトロニクス株式会社	前工程生産技術統括部 プロセス加工技術部	部長兼リソグラフィプロセス技術課課長
	島根 誉	ローム株式会社	WP生産本部 WP統括	統括部長
	奥野 泰利	株式会社SCREENホールディングス		執行役員 特命担当
	渡部 潔	一般社団法人日本半導体製造装置協会		専務理事
	浜島 雅彦	SEMIジャパン		代表取締役社長
	嵯峨 幸一郎	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社	研究開発センター 第2研究部門 2部4課	統括課長
	茂木 弘典	東京エレクトロン株式会社	Corporate Technology本部 革新技術開発センター 装置インテリジェンス開発部	部長
	嶋崎 綾子	東芝ナノアナリス株式会社		技師長
	佐々木 智幸	タワー パートナース セミコンダクター株式会社		産学連会・渉外担当 Senior Principal
	櫻井 岳暁	筑波大学	数理物質系	大学執行役員(研究マネジメント) 地域責任者 (北米・インド)、教授
	内野 敏幸			

プログラム委員会

プログラム委員会	氏名	所属機関名	部署	役職名
プログラム委員長	井ノ本 実	キオクシア株式会社	先端技術研究所AI・システム研究開発センター AI・DX技術研究開発部	部長附
プログラム副委員長	中川 聡子	グローバルウェア・ジャパン株式会社	技術部基盤技術グループ	主事
	加藤 凡典	イー・アイ・ティ		代表取締役
	水野 晋介	アプライドマテリアルズジャパン株式会社	PDCプロダクトマネージメント	マネージャー
	Christophe Vallee	College of Nanotechnology, Science, and Engineering (CNSE), University at Albany – SUNY	Department of Nanoscale Science & Engineering	Professor
	根本 和典	株式会社日立ハイテク	ナノテクノロジーソリューション事業統括本部 事業戦略本部事業戦略部	マーケティングストラテジスト
	土山 洋史	インフィコン	Semiconductor Segment	Director
	大見 俊一郎	東京科学大学	工学院 電気電子系	准教授
	新保 正博	株式会社JSファンタリ	技術統括部 プロセス技術開発部	主任技術員
	青木 正身	ケーエルエー・テンコール株式会社	プロセス・コントロール・ソリューションズ	アジア・リージョナル・ディレクター
	Sung Min Yoon	Kyung Hee University, Korea		Associate Professor
	南百瀬 勇	ナモテック		代表
	三宅 賢治	オフィス三宅		代表
	渡邉 健二	Rapidus株式会社	デバイス技術部	シニアエンジニア
	藤城 明弘	ルネサス エレクトロニクス株式会社	オペレーショングループ /AI技術推進部	Senior Manager 課長
	岩本 邦彦	ローム株式会社	LSI開発本部 LSIデバイス開発部 プロセス開発課	課長
	久松 貴将	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社	長崎TEC MIS製品部門 デバイス技術1部 技術2課	統括課長
	松川 和人	株式会社SUMCO	生産技術本部 副本部長 マーケティング技術部	常務執行役員 部長
	小西 敏雄	テクセンドフォトマスク株式会社	事業戦略部	課長
	田村 利幸	日本テキサス・インスツルメンツ株式会社	美浦ウエハーファブ	
	ボス スボロジャ	東京エレクトロン株式会社	Innovation X Lab.	
	田中 知哉	タワー パートナース セミコンダクター株式会社	プロセステクノロジーセンタープロセス技術開発部 イールドマネジメント開発課	課長
	安井 孝俊	タワー パートナース セミコンダクター株式会社	プロセステクノロジーセンター プロセス技術開発部 イールドマネジメント開発課	主幹技師
	松本 剛征	ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	経営企画統括部 製造企画部	
	有馬 澄佳	筑波大学	システム情報系 社会工学域 ファカルティシステム情報工学研究科	講師

【ISSM2026 協賛金特典内容】

種別	プラチナ	ゴールド	シルバー	ブロンズ	リフレッシュメント	ストラップ
募集上限	—	—	—	—	2	1
協賛金（税別）	¥800,000	¥600,000	¥400,000	¥200,000	¥200,000	¥250,000
ISSM 参加						
シンポジウムへの無料参加人数 参加費（予定） 一般（早期割引） 40,000円 一般（通常・当日） 50,000円 学生（予稿集なし） 無料 学生（予稿集あり） 3,000円	6	4	2	1	1	1
Visibility						
ISSMウェブサイト （ロゴから企業HPへリンク）	上段	中段（上）	中段（下）	下段	下段	下段
キーノート前に1分間のPR動画投影 （希望ベース）	有	有	無	無	無	無
予稿集に企業ロゴ掲載、ホームページへリンク	有	有	有	有	有	有
インターバルスクリーン上に企業ロゴを表示	有	有	有	有	有	有
会場ポスターに企業ロゴを表示	有	有	有	有	有	有
Refreshmentテーブルに企業ロゴを表示	無	無	無	無	有	無
ストラップに企業名を表示	無	無	無	無	無	有
展示スペース提供						
展示スペースとして下記をご用意します。 ・テーブル W1800xD450xH720 ・バックパネル W1800xH1800 ※電源（10V 500W）をご希望の場合は 別途6,000円（税別）の追加が必要となります ※白布はございません ※展示期間は2日間（初日は10時半頃開始、最終日は 15時頃終了予定） ※テーブル・バックパネルのサイズは若干の変更の可 能性がございます。最終サイズは9月中旬にご案内の 展示スペース案内をご確認下さい。	有	有	有	有	無	無

ぶら下げ金具付ストラップ
提供(250本予定) の場合は
50,000円引き

※展示スペース提供は設置可能数に限りがございますため先着順となります。

※ポスターへのロゴ掲載は 2026 年 10 月末お申込みが期限となります。

※お申込み期限:2026 年 10 月末(お申込数の上限があるリフレッシュメントおよびストラップスポンサーは、先着順にて締切となります)

■ISSM 事務局

株式会社セミコンダクタポータル

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-4 アーバン虎ノ門ビル 6F

Tel: 03-6807-3970 Fax: 03-6807-3960

E-mail: issm_2026@semiconportal.com